

**平成25年3月期
(第11期)
第2四半期決算説明会**

**平成24年11月7日
株式会社ジーダット**

- 1. 平成25年3月期 第2四半期決算概要**
- 2. 下期拡販戦略と今後の取り組み**
- 3. 平成25年3月期通期予想**

平成25年3月期第2四半期決算のポイント

景況予想以上に厳しく、上半期計画比 売上高: $\Delta 13.0\%$

固定費圧縮・助成金収入により、経常利益は計画通り

上期研究開発投資及び製品開発は、ほぼ計画通り

上半期前年同期比 売上高: $\Delta 15.4\%$

市場別売上高 半導体: $\Delta 14.5\%$ 、FPD: $\Delta 16.3\%$

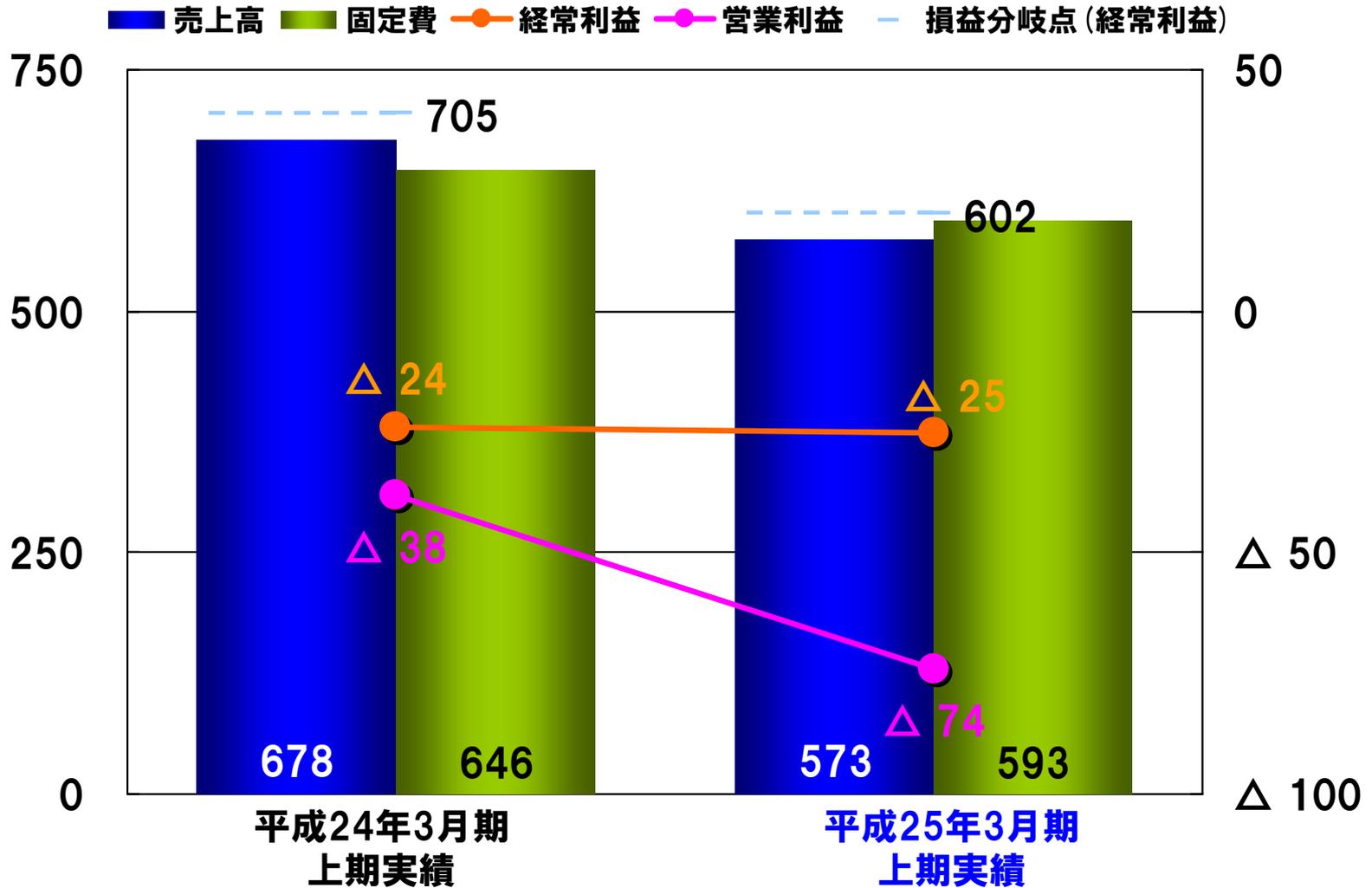
上半期実績 - 前年同期比・計画比 -

(単位:百万円)

	平成24年3月期 上半期実績	平成25年3月期上半期			
		計画	実績	前年 同期比	計画比
売上高	678	660	573	△15.4%	△13.0%
売上総利益	490 (72.4%)	523 (79.3%)	462 (80.5%)	△5.9%	△11.7%
販売費及び 一般管理費	529	566	536	1.3%	△5.4%
営業利益	△ 38	△ 43	△ 74	-	-
経常利益	△ 24	△ 25	△ 25	-	-
四半期純利益	△ 14	△ 26	△ 28	-	-

上半期売上高・利益 - 前年同期比 -

(単位:百万円)



連結貸借対照表 - 前期末比 -

(単位:百万円)

	平成24年 3月期末	平成24年 9月末	差異		平成24年 3月期末	平成24年 9月末	差異
(資産の部)				(負債の部)			
I 流動資産	2,340	2,656	315	I 流動負債	235	585	350
1 現金及び預金	1,969	2,502	532	1 買掛金	23	32	9
2 受取手形及び売掛金	229	109	△120	2 短期借入金	—	200	200
3 有価証券	99	—	△99	3 未払法人税等	5	4	△0
4 たな卸資産	4	4	△0	4 前受金	108	252	143
5 繰延税金資産	—	—	—	5 賞与引当金	37	36	△0
6 前渡金	9	13	3	6 その他	60	59	△1
7 その他	25	26	1	負債合計	235	585	350
II 固定資産	73	66	△6	(純資産の部)			
1 有形固定資産	29	25	△3	I 株主資本	2,178	2,141	△37
2 無形固定資産	19	14	△5	1 資本金	760	760	—
3 投資その他の資産合計	24	26	1	2 資本剰余金	890	890	—
(1) 投資有価証券	—	—	—	3 利益剰余金	561	523	△37
(2) 長期定期	—	—	—	4 自己株式	△32	△32	—
(3) 繰延税金資産	—	—	—	II 評価・換算差額等	△0	△4	△3
(4) その他	24	26	1	為替換算調整勘定	△0	△4	△3
				其他有価証券	—	—	—
				評価差額金	—	—	—
資産合計	2,413	2,722	309	純資産合計	2,177	2,136	△41
				負債純資産合計	2,413	2,722	309

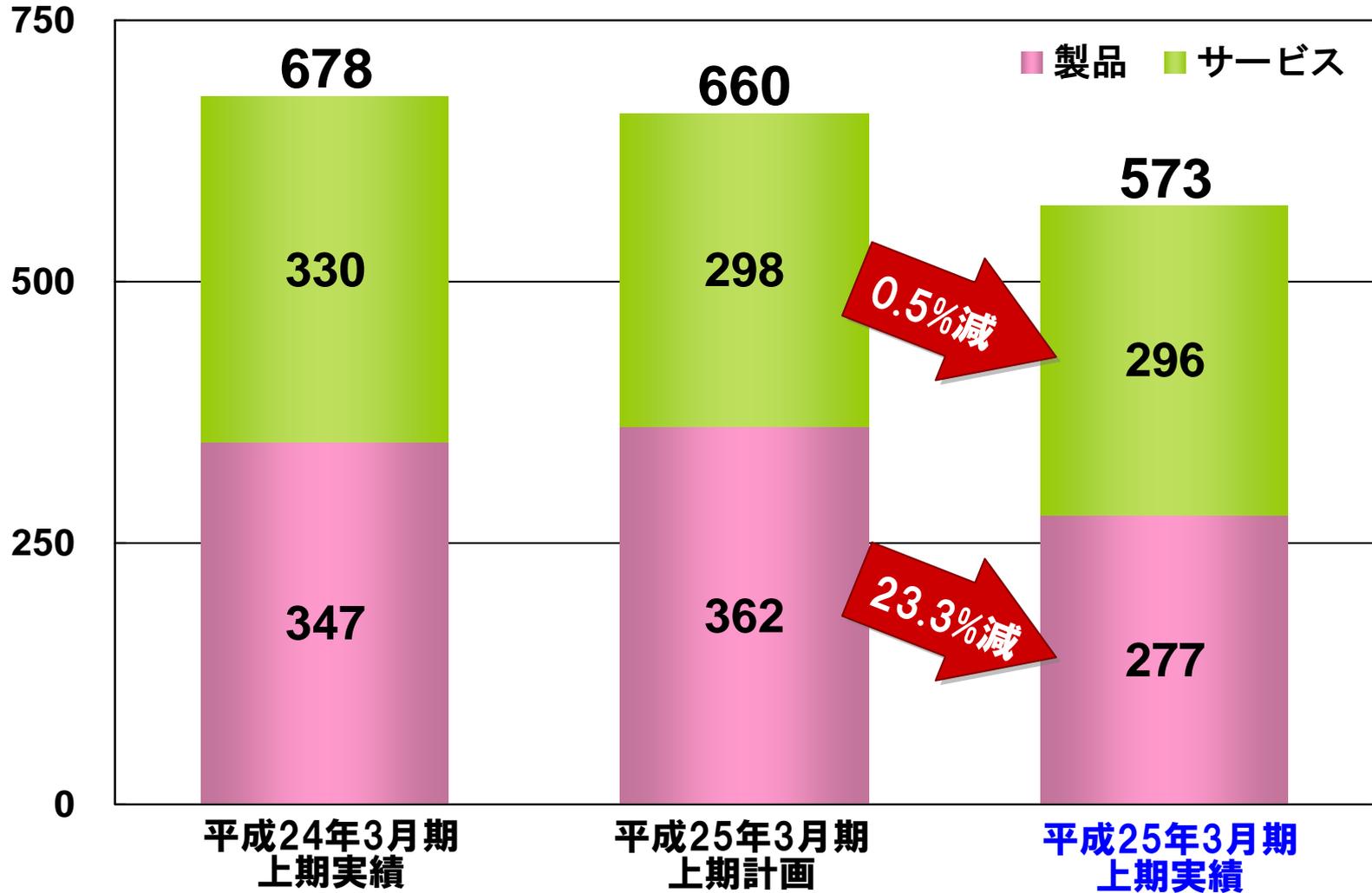
連結キャッシュフロー計算書 - 前年同期比 -

(単位:百万円)

	平成23年4月1日 ～ 平成23年9月30日	平成24年4月1日 ～ 平成24年9月30日	差異
I 営業活動によるキャッシュ・フロー	92	252	160
II 投資活動によるキャッシュ・フロー	281	93	△188
III 財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 19	190	209
IV 現金及び現金同等物に係る換算差額	△ 2	△3	△0
V 現金及び現金同等物の増減額 (減少:△)	352	532	180
VI 現金及び現金同等物の期首残高	854	1,069	215
VII 現金及び現金同等物の期末残高	1,209	1,602	393

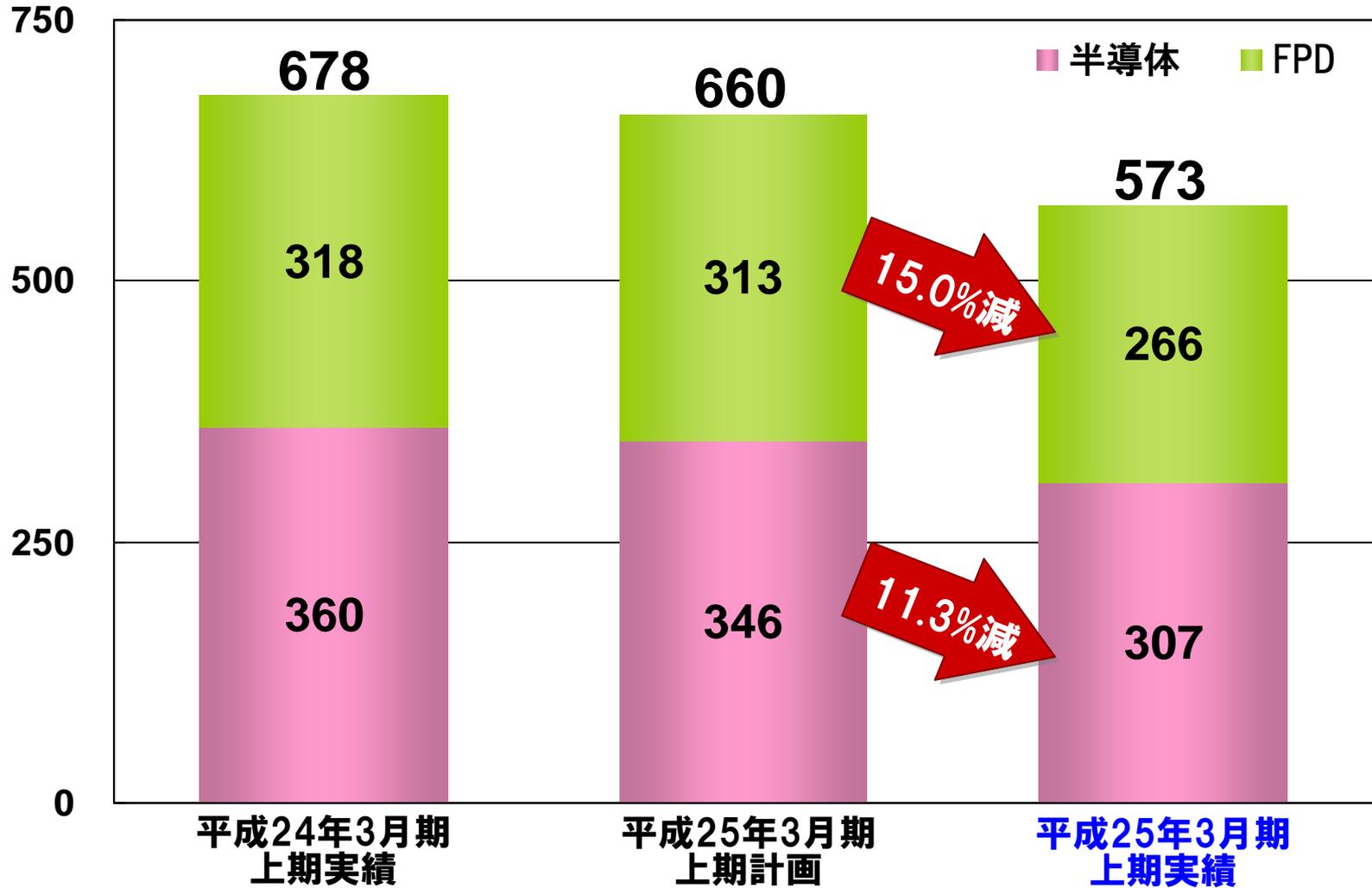
上半期事業別売上高（製品/サービス） - 計画比 -

（単位：百万円）



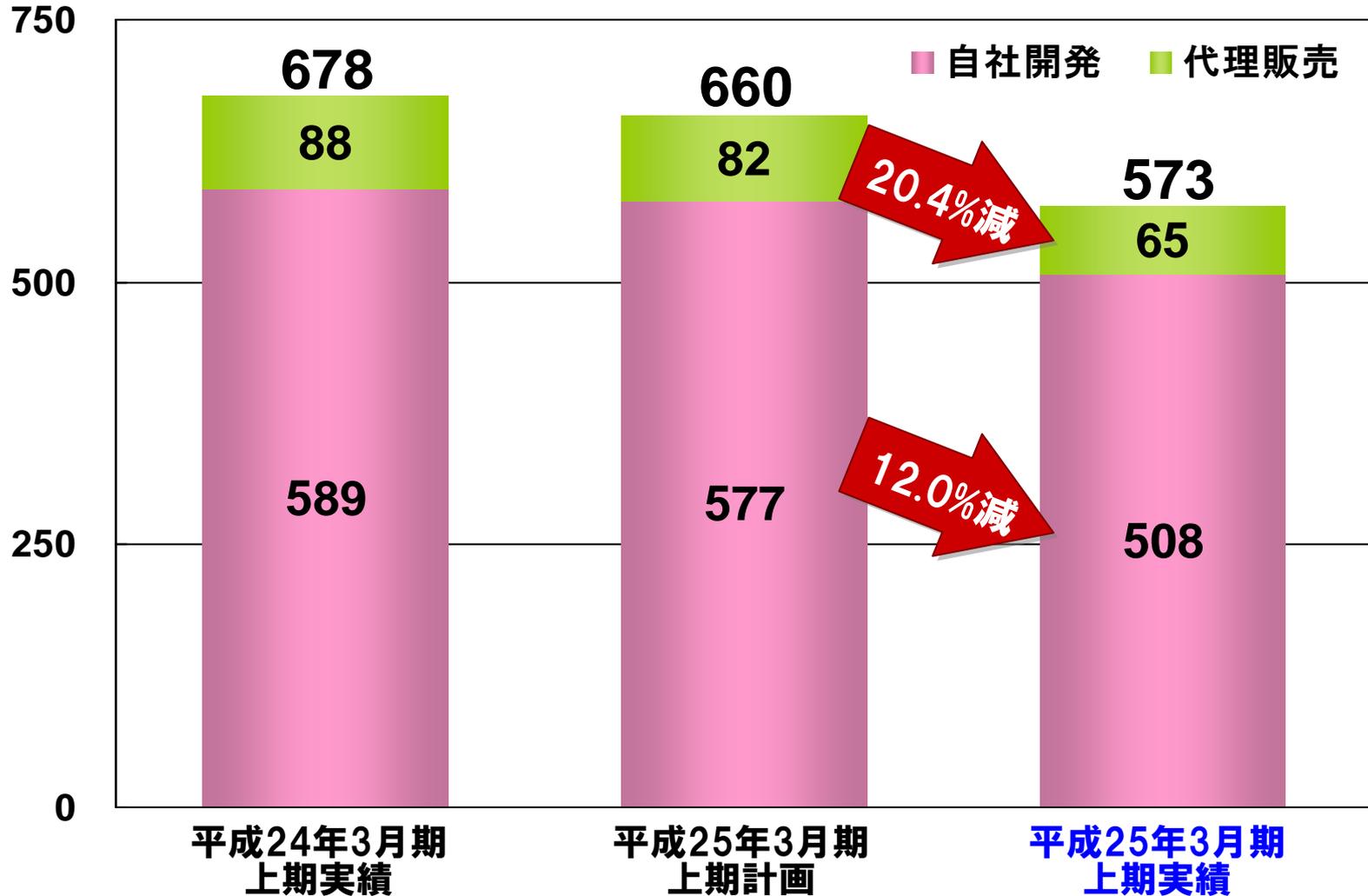
上半期市場別売上高 (半導体/FPD) -計画比-

(単位:百万円)



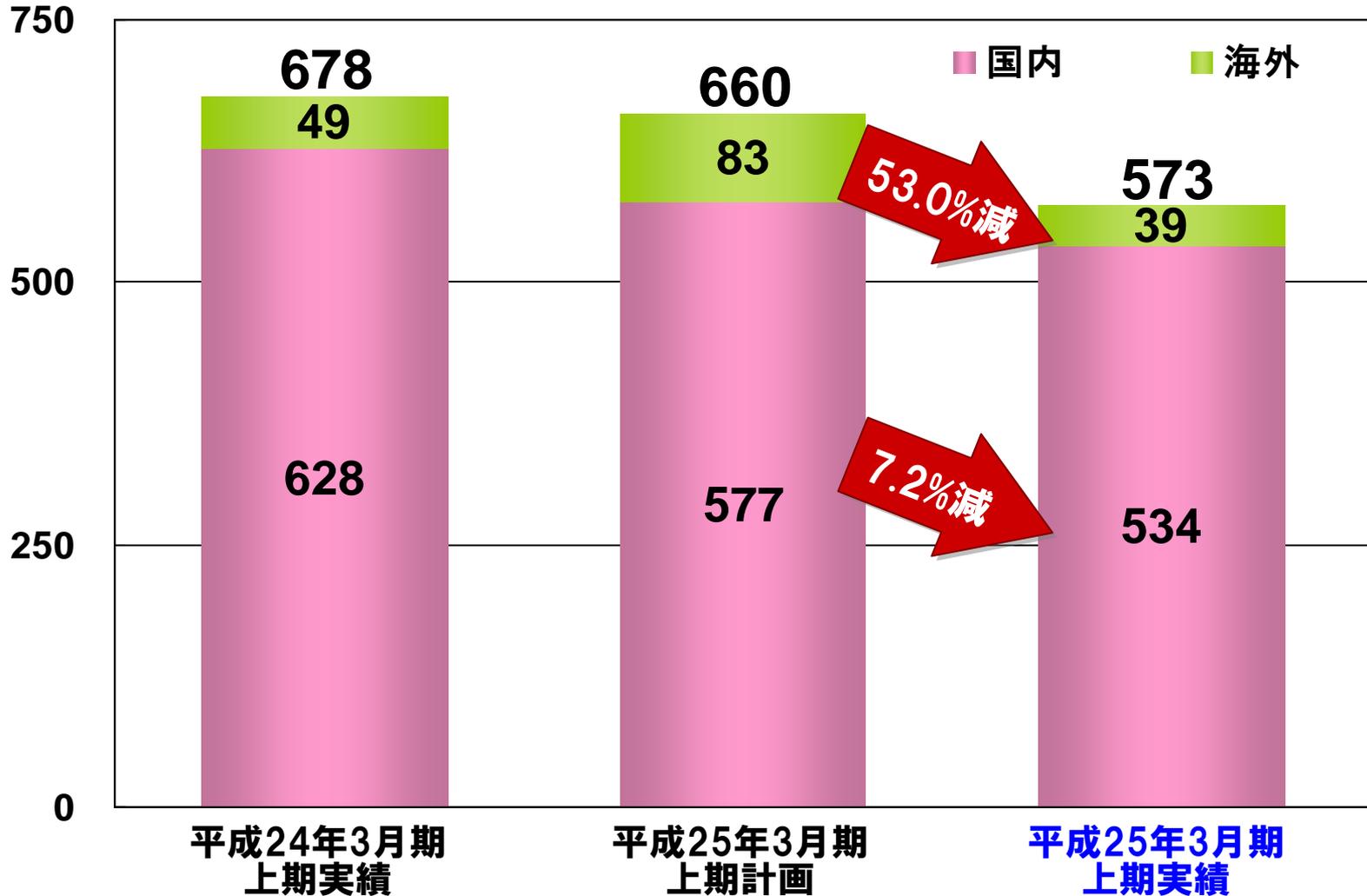
上半期製品区分別売上高 (自社開発/代理販売) - 計画比 -

(単位:百万円)



上半期販売先別売上高 (国内/海外) - 計画比-

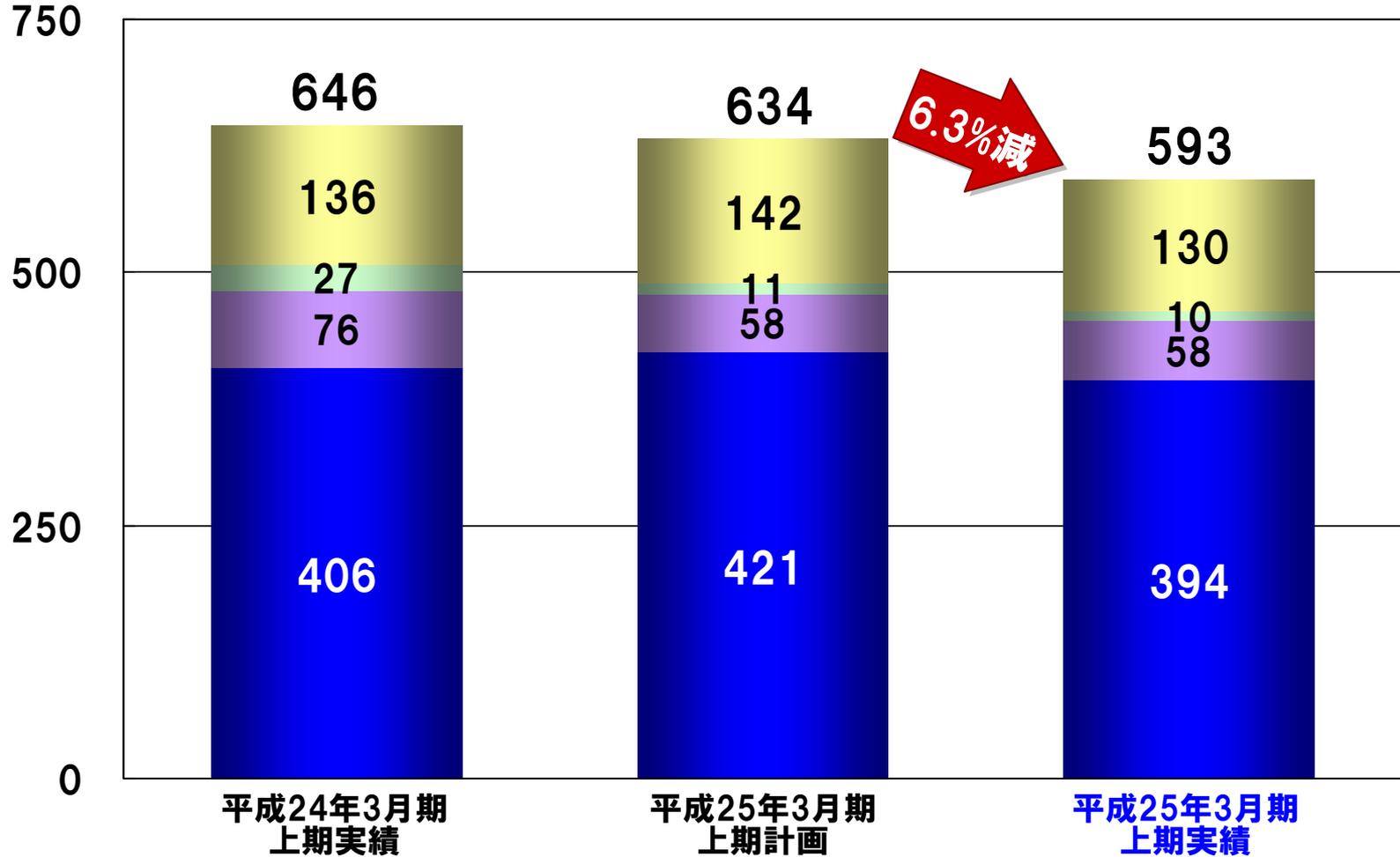
(単位:百万円)



上期固定費内訳 - 計画比 -

(単位:百万円)

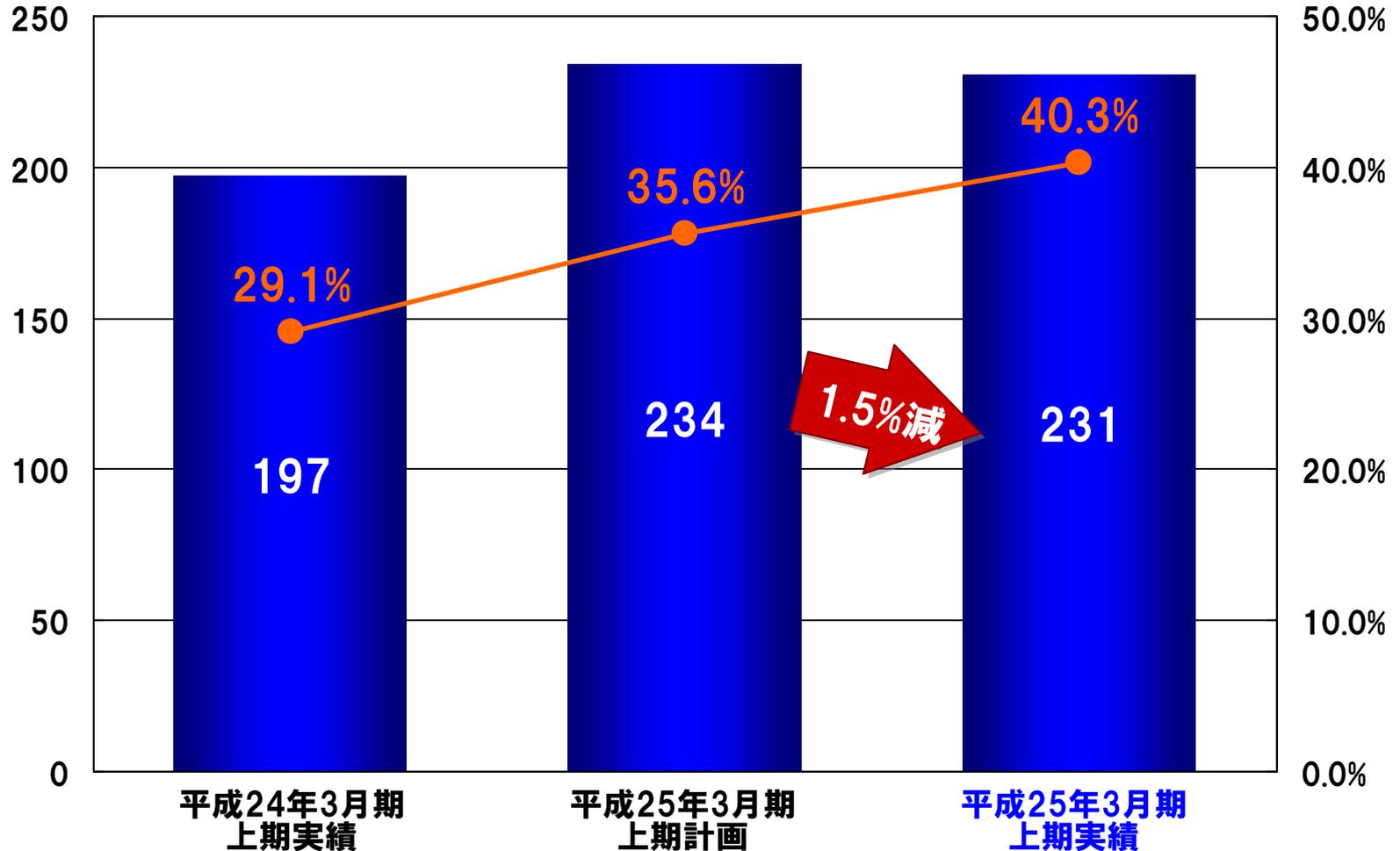
■ 人件費 ■ 外注費 ■ 減価償却・のれん償却費 ■ その他経費



研究開発費 - 計画比 -

(単位:百万円)

■ 研究開発費 ● 売上高比



上半期概況

国内半導体・FPD

軒並み業界再編

一部モバイル/自動車関連は活況

予算凍結
予算削減

新規商談

海外FPD

中国 TV向け設備投資の減速

韓国 高精細有機ELに移行

台湾 4K2K/高精細中小型に移行

商談シフト
が発生

新規商談

海外半導体

新規/最先端技術志向

即成果には
繋がらず

主なトピックス

海外半導体市場向け活動

欧米向け販促活動

インド向け販促活動

台湾向け販促活動

- DAC※出展
- 顧客訪問
- 協力会社調査

製品リリース

海外半導体向けツール群

半導体向け制約検証ツール

タッチパネル、有機EL向けツール

パワー半導体向けツール

Anchor
シリーズ

NEW

HayatoDCC

NEW

FineQap

FineVolt

PowerVolt

※ DAC (Design Automation Conference) :EDA業界最大の展示会

- 1. 平成25年3月期 中間決算概要**
- 2. 下期拡販戦略と今後の取り組み**
- 3. 平成25年3月期通期予想**

下期拡販戦略

国内半導体・FPD

モバイル/自動車関連をメインに活動

中小型高精細パネル

タッチパネル

有機ELパネル

パワー半導体

イメージセンサ

ドライバIC

海外FPD

商談の今期内クロージングに注力

高精細/有機ELにフォーカス

海外半導体市場

引き続き販促活動を継続

今後の取り組み：製品開発関連

回路検証系の新製品をリリース

新しいアナログ検証手法に対応

NEW

Cforce

主力製品の大幅バージョンアップ

データ軽量化/パフォーマンスアップ

最先端の業界標準対応

各種機能強化/使い勝手向上



α-SX
V4.0

今後の取り組み: 来期以降への活動

海外半導体向け製品戦略の検討

最先端アナログLSI向け自動設計ツール

設計資産の再利用に向けた設計支援環境

カスタムソフト受託開発の間口拡大

EDA関連からEDA周辺アプリまで拡大

海外協力会社との相互販売提携調査

相互の製品取扱い/コラボレーション

- 1. 平成25年3月期 中間決算概要**
- 2. 下期拡販戦略と今後の取り組み**
- 3. 平成25年3月期通期予想**

平成25年3月期通期予想のポイント

国内の景況は一部を除くと厳しい見通し

海外商談は国内と比較すると不確定要素が大きい

固定費の圧縮は下期も継続

研究開発投資及び製品開発費は高水準を維持

通期予想 -前年同期比-

(単位:百万円)

	平成24年 3月期実績	平成25年3月期	
		当初計画	前年同期比
売上高	1,331	1,350	1.4%
営業利益	△ 92	△ 60	-
経常利益	△ 9	20	-
当期純利益	△ 229	16	-



**ご清聴
ありがとうございました**